



**技术要求：**

1. 绝缘电阻：5000M @500V
2. 介电耐压：300V
3. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命：500次
5. 温度范围：-65 ~ +155
6. 镀层厚度：1.27 $\mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

|  |    |    |       |     |    |      |    |     |
|--|----|----|-------|-----|----|------|----|-----|
|  |    |    |       |     |    | 装配图  |    |     |
|  |    |    |       |     |    |      |    |     |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 | 图样标记 | 重量 | 比例  |
|  | 设计 | M。 |       | 标准化 |    |      |    | 7:1 |
|  | 审核 |    |       |     |    |      |    |     |
|  | 工艺 |    |       | 日期  |    | 共    | 页  | 第   |
|  |    |    |       |     |    |      |    |     |

HN-LP3-0.5-1.27(5.7-1.5)M

成都恒利泰科技有限公司


 成都恒利泰科技有限公司  
 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd